Best consulting

全球半导体行业周报

韩国芯片出口增长 259.4%，设备指引上调，Intel 营收指引下降

发布主体：百思特变革研究院半导体智库 | 期次日期：2026-11-01 | ISO 2026 年第 44 周 | 覆盖窗口：2026-10-26 至 2026-11-01 | 截至北京时间 2026 年 11 月 2 日 05:00

本期总判断

存储、制造设备与通用处理器的增长速度继续拉开。韩国 10 月芯片出口同比增长 259.4%，Intel 四季度营收指引中值较三季度下降约 6.1%。

存储供应商的利润与长约增加。 SK hynix 三季度营收 104.6155 万亿韩元。14 家客户已签长期协议，覆盖超过一半的 2027—2028 年产能。[S01]

设备厂的收入继续增长。 KLA 下一季度营收指引中值 47 亿美元，较本季增长约 13.6%。TEL 九月季度营收环比增长 27.7%。[S05、S09]

服务器与个人电脑需求分化。 Intel 数据中心与 AI 业务营收同比增长 78%，客户计算业务下降 5%。采购预算需要分开评估。[S04]

资本市场： SOX 收于 10,688.80 点，10 月 30 日下跌 7.20%。科创 50 收于 1,160.84 点，周跌 13.73%。[S30、S31]

宏观约束： 美债 10 年期收益率为 4.94%，较前周下降 6 个基点。设备交付、存储成本和客户现金流仍需同时观察。[S32]

下一阶段需要跟踪的关键变量： 11 月 2—5 日陆续公布的芯片企业财报、存储长约执行，以及设备出货转为客户验收的速度。

目录

本周概览.....3
一、本周要点.....6
二、重大事件及其影响.....6
三、行业景气与资本市场.....7
四、存储周期与装备制造链.....9
五、政策、贸易与供应链安全.....9
六、重点企业动态.....11
七、中国半导体产业链.....12
八、行业会议与人物观点.....12
九、趋势判断.....13
十、主要风险与下周关注事项.....14
十一、管理观察与行动建议.....15

阅读导引：经营管理者可先读“本周要点”“趋势判断”与“管理观察与行动建议”；技术与供应链负责人可重点阅读“存储周期与装备制造链”“重点企业动态”和“主要风险与下周关注事项”。

百思特管理咨询集团

本周概览

关键指标

韩国半导体出口（10 月） **564.4 亿美元** **同比+259.4%** 11 月 1 日发布；占总出口约 49.0%[S28]	费城半导体指数（10 月 30 日） **10,688.80** **单日-7.20%** Nasdaq 收盘价指数；周涨跌另列正文[S30]	科创 50（10 月 30 日） **1,160.84** **周-13.73%** 10 月 23 日 1,345.514；原始精度计算[S31]
SK hynix 三季度营收 **104.6155 万亿韩元** **同比+328%，环比+32%** 10 月 28 日；公司实际值[S01]	KLA 下一季度营收指引中值 **47.0 亿美元** **比本季约+13.6%** 区间 45 亿—49 亿美元；公司预测[S05]	美债 10 年期收益率（10 月 30 日） **4.94%** **周-6 个基点** 10 月 23 日 5.00%；每日 CMT[S32]

一周大事记

10 月 26 日
周一

- Broadcom 合作方宣布 630 亿美元 SPV 融资承诺，预计 2027 年开始交付
- Cadence 公布季度营收 16.33 亿美元
- Amkor 公布季度营收 19.91 亿美元[S18、S16、S15]

10 月 27 日
周二

- NXP 季度营收 37.86 亿美元
- ASMI 季度营收 11.594 亿欧元
- Infineon 宣布至 2034 年投资约 11 亿欧元建设 300mm GaN 产线
- NVIDIA 与 Oracle 扩大算力合作[S07、S06、S22、S19]

10 月 28 日
周三

- SK hynix 公布季度营收 104.6155 万亿韩元
- KLA 公布季度营收 41.36 亿美元
- 联电利用率达到 92%
- Advantest 上调年度预测
- Lam 与 imec 扩大研发合作[S01、S05、S13、S10、S21]

10 月 29 日
周四

- Samsung 公布完整季度业绩及年度资本支出计划
- Intel 四季度营收指引 150 亿—160 亿美元
- Sandisk 下一季营收指引 122 亿—126 亿美元
- ST 与 Renesas 公布业绩[S02—S04、S12、S08、S17]

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

10 月 30 日 周五	▪ TEL 九月季度营收 9,350 亿日元 ▪ MediaTek 公布营收 1,680.58 亿新台币 ▪ 北方华创、中微公司等披露三季报 ▪ SOX 单日下跌 7.20%[S09、S14、S23、S24、S30]
10 月 31 日 周六	▪ 中国制造业 PMI 为 49.3，较 9 月下降 0.8 点 ▪ 长鑫科技披露三季度营收 1,187.14 亿元、归母净利润 544.35 亿元 ▪ 华海清科季度营收 15.39 亿元[S29、S26、S61]
11 月 1 日 周日	▪ 韩国公布 10 月半导体出口 564.4 亿美元 ▪ SEMI ITPC 会期为 11 月 1—4 日，会议主题包括产业投资与供应链[S28、S35]

本周图表

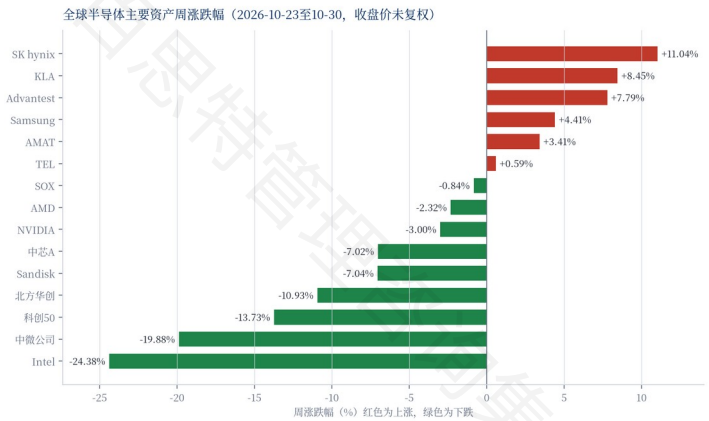


图 1　主要半导体资产周涨跌幅。比较 10 月 23 日与 30 日收盘；台湾个股前端为 10 月 22 日。资料：StockAnalysis、Yahoo Finance 与交易所历史数据；详见第四章。

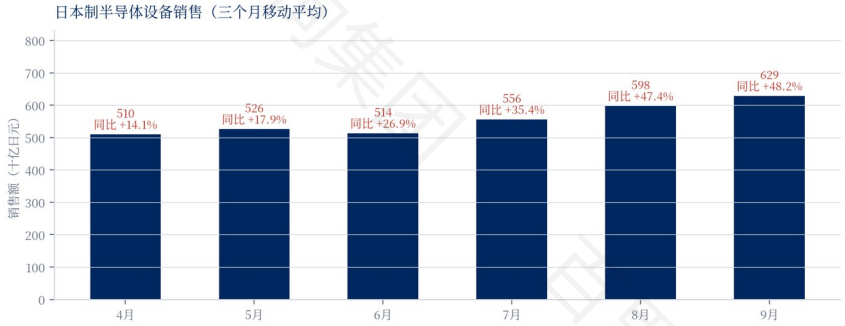


图 2　日本制半导体设备销售，三个月移动平均。资料：SEAJ，9 月数据于 10 月 23 日公布；单位为十亿日元[A02]。

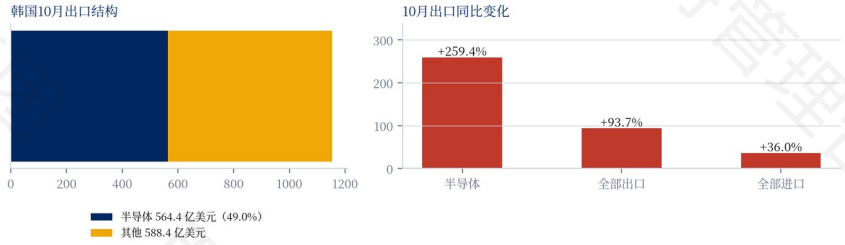


图 3　韩国 10 月出口结构及同比增速。资料：11 月 1 日进出口月报；金额单位为亿美元[S28]。

百思特管理咨询集团

一、本周要点

韩国芯片出口增长 259.4%，设备指引上调，服务器与个人电脑的需求方向不同。

- **韩国 10 月芯片出口同比增长 259.4%。** 金额 564.4 亿美元，占总出口约 49.0%。出口金额同时受数量与单价影响，不能等同于芯片出货量增速。[S28]
- **SK hynix 超过一半的 2027—2028 年产能进入长期协议。** 公司披露 14 家长约客户。客户预订、实际投片和收入确认仍有时间差，2027 年设备采购应按执行进度核对。[S01]
- **Samsung 半导体部门季度营业利润 106.5 万亿韩元。** 该部门营收 147.1 万亿韩元，计算营业利润率约 72.4%。集团全年资本支出计划 84.4 万亿韩元。[S02、S03]
- **Intel 下一季营收指引中值 155 亿美元。** 三季度营收约 165 亿美元。数据中心与 AI 业务同比增长 78%，客户计算业务下降 5%。同一公司内部需求方向不同。[S04]
- **KLA 下一季度营收中值较本季增长 13.6%。** 中值 47 亿美元，本季 41.36 亿美元。设备交付改善，仍需观察客户验收与服务收入的持续性。[S05]
- **TEL 九月季度营收环比增长 27.7%。** 季度金额 9,350 亿日元。公司给出的财年营收预测为 3.7 万亿日元，财年截至 2027 年 3 月。[S09]
- **Sandisk 下一季营收指引中值 124 亿美元。** 本季 110.31 亿美元。数据中心收入环比增长 61%，消费业务下降 29%。企业级与零售需求分别变化。[S12]
- **联电三季度产能利用率为 92%。** 22nm 收入占晶圆销售 18.3%，22/28nm 合计 35%。成熟与特殊工艺需求改善，但不代表全部节点同时满产。[S13]

二、重大事件及其影响

10 项事件分别涉及存储、制造设备、晶圆代工、融资与功率器件。

事件	环节	产业影响	来源
SK hynix 公布季度业绩（10/28）	存储	营收 104.6155 万亿韩元；14 家长约客户；供货安排延伸至 2027—2028 年	公司公告[S01]；高
Samsung 公布完整财报（10/29）	存储与代工	DS 营业利润 106.5 万亿韩元；资本支出分配需与集团总额分开	公司公告[S02、S03]；高
Intel 公布指引（10/29）	CPU 与制造	下一季营收中值 155 亿美元；服务器业务与客户计算业务增速不同	公司财报[S04]；高
KLA 季度业绩及指引（10/28）	检测量测	下一季度中值 47 亿美元，比本季约增长 13.6%	公司财报[S05]；高
TEL 公布财年预测（10/30）	前道设备	财年营收预测 3.7 万亿日元，较上财年增长 51.4%	公司财报[S09]；高
Sandisk 季度业绩（10/29）	NAND 与 SSD	数据中心收入环比增长 61%，下一季营收中值 124 亿美元	公司公告[S12]；高
联电季度业绩与资本预算（10/28）	特殊工艺	利用率 92%；另批准 1,027.81 亿新台币资本预算	公司披露[S13]；高
Broadcom 相关融资承诺（10/26）	AI 芯片与融资	630 亿美元 SPV 结构；设备交付预计从 2027 年开始	合作方公告[S18]；高
Infineon 宣布 GaN 投资（10/27）	功率半导体	至 2034 年约 11 亿欧元；300mm 工艺扩大电源器件生产能力	公司公告[S22]；高
对外投资规则修订草案（10/26）	跨境投资	意见截止 12 月 7 日；技术范围与交易主体分类影响投资安排	公开文件[S33]；高

三、行业景气与资本市场

日本制九月设备销售同比增长 48.2%，韩国十月芯片出口同比增长 259.4%。

行业金额数据保持高增速，但统计周期和业务范围不同。SIA 八月销售额为三个月移动平均，SEAJ 九月设备销售同样采用三个月平均。韩国月度出口为十月全月数据。[A01、A02、S28] 这些指标支持行业名义收入扩大，不能直接解释全部终端的采购数量。

指标	最新值与期间	比较	来源
全球芯片销售	8 月 1,597 亿美元；三个月平均	同比+144.3%，环比+8.0%	SIA[A01]
日本制制造设备	9 月 6,290.40 亿日元；三个月平均	同比+48.2%，环比+5.2%	SEAJ[A02]
韩国芯片出口	10 月 564.4 亿美元	同比+259.4%；占总出口约 49.0%	月度统计[S28]
制造业 PMI	10 月 49.3	9 月 50.1；下降 0.8 点	统计发布[S29]
台湾外销订单	9 月 1,142 亿美元	同比+62.4%；包括海外生产	月度统计[S44]
美债 10 年期	10 月 30 日 4.94%	10 月 23 日 5.00%；下降 6 基点	Treasury[S32]

据 Yahoo Finance 历史数据，SOX 周跌 0.84%。[M09] Nasdaq 列示 10 月 30 日单日跌 7.20%。[S30] 科创 50 周跌 13.73%。[S31] 据 Investing 历史数据，同期 KOSPI 上涨 3.25%。[M01] 市场变化与企业经营存在时间差。Intel、KLA 和 SK hynix 的周表现差异较大，体现业务预期与市场估值的不同变化。

代表资产	前端收盘	本周收盘	周变化
SOX	10/23 10,779.46	10/30 10,688.80	-0.84%
科创 50	10/23 1,345.514	10/30 1,160.838	-13.73%
SK hynix（韩元）	1,277,000	1,418,000	+11.04%
KLA（美元）	145.61	157.91	+8.45%
Intel（美元）	86.96	65.76	-24.38%
半导体 ETF 512480（元）	0.836	0.720	-13.88%
芯片 ETF 159995（元）	0.909	0.783	-13.86%

证券表现以当地货币收盘价计算，未计分红与汇率收益。两只 ETF 使用三位小数原值。股价变化只能说明该期间的市场结果，不能作为单一事件因果关系的证明。企业配置资源仍应依据产品需求、现金流和执行能力。

四、存储周期与装备制造链

存储长约覆盖未来供货，KLA 与 TEL 本周披露的收入和指引继续增加。

SK hynix 披露 14 家长期协议客户，覆盖超过一半的 2027—2028 年产能。[S01] 长约可改善供货安排，也会增加客户最低采购量等合同约束。Samsung 年度资本开支计划 84.4 万亿韩元。[S03] 工厂建设、设备到货与实际量产之间仍有时间差，供应商应按客户正式采购与验收安排排产。

存储企业的终端收入出现差别。Sandisk 数据中心业务环比增长 61%，消费业务下降 29%。[S12] Kioxia 九月季度收入较前季增加约 40.3%，下一季度预计与本季接近。[S11] 价格保持高位与涨幅放缓可以同时发生。客户应分别评估企业级、手机与消费存储的需求。

设备企业的增量来自不同工艺环节。KLA 下一季营收中值 47 亿美元，TEL 财年营收预测 3.7 万亿日元，Advantest 财年营收预测 1.863 万亿日元。[S05、S09、S10] 检测、前道制造和测试的收入依据不同。订单增长应与交货、客户认证及工程服务能力一起评估。

项目	最新证据	执行关注
长期供货	SK hynix14 家长约客户[S01]	价格条款、预付款、最低采购量与提货时间
前道设备	ASMI 下一季收入 12.30 亿欧元±5%[S06]	固定汇率口径；客户项目和工艺组合
测试设备	Advantest 半年营收同比+60.5%[S10]	测试时间增加、设备产能与客户利用率
材料与器件	高容 MLCC 紧张预计延续至 2027 年上半年[A06]	具体规格、认可供应商与替代料认证

KLA 下一季度营收中值 47 亿美元，较本季增长约 13.6%。[S05] 量测检测需求与其他设备工艺分别评估。供应商宜按研发样机、客户认证与商业交付划分预算。

日月光 ATM 三季度营收 1,514.85 亿新台币，增长 51.0%，毛利率 30.6%。[S58] SCREEN 半年营收 3,084.53 亿日元，增长 12.5%。[S56] 两者分别提供封测与设备的经营依据，不能与集团合并收入混算。

五、政策、贸易与供应链安全

10 月 26 日的对外投资规则修订文件仍为草案，意见截止 12 月 7 日。

公开文件 2026-21786 提出对外投资规则修订，涉及先进半导体、相关设备和设计软件等技术领域。[S33] 企业应核对投资主体、交易类型和技术参数。征求意见稿与现行有效要求分别处理。合同中的许可、审批和延期责任需要明确，不能仅依据报道标题改变项目结论。

10 月 27 日发布的材料文件将氦加入关键材料清单。[S34] 氦与半导体制造、检漏及低温应用有关。供应管理可检查纯度、用量、储备和回收方案。新增材料分类不自动产生采购价格变化，也不等同于新进口税率。

事项	阶段	对企业的影响
对外投资规则修订	草案；意见截止 12/7	按具体交易与技术范围评估，保留后续规则变化条款
氦的材料分类	已发布通知	评估供应连续性、纯度要求及回收经济性
跨境采购和融资	按合同与适用要求执行	融资承诺、订单、设备产权和付款义务分别记录

跨境项目应为技术适配、供货许可、交付和付款设置清楚的责任。融资额度不能替代客户使用需求。多年设备采购合同也需要检查取消、延期及性能不达标的处理方式。经营计划应保留可调整的批次，避免尚未交付的规划规模提前占满预算。

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

六、重点企业动态

8 组重点企业显示存储、设备、服务器与消费需求的不同变化。

企业	本周事项	经营观察	来源
SK hynix / Samsung	未来两年长约覆盖与季度高利润	比较供货、资本支出与客户成本	S01—S03
Intel	服务器业务同比+78%，客户计算-5%	下一季营收中值 155 亿美元	S04
KLA / TEL	下一季中值 47 亿美元；财年 3.7 万亿日元	分别核对季度与财年，跟踪验收	S05、S09
Sandisk / Kioxia	企业级需求高于消费端；收入继续增加	比较产品组合与下一季增速	S11、S12
联电 / MediaTek	利用率 92%；库存周转 127 天	制造需求改善与设计企业备货并看	S13、S14
NXP / ST	工业 IoT 收入+39%；ST 下一季中值 4 1.5 亿美元	按汽车、工业、通信分别判断	S07、S08
Broadcom / NVIDIA	融资结构 630 亿美元；多吉瓦系统部署计划	承诺、部署与已确认收入分阶段	S18、S19
北方华创 / 中微	季度营收同比+1.31%和+17.18%	扣非利润、交付和现金流分开	S23、S24

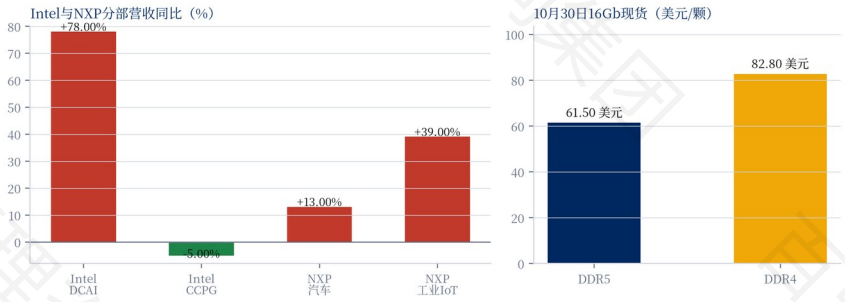


图 4　Intel 与 NXP 分部营收同比及 DRAM 现货价。价格为 10 月 30 日 16Gb 规格报价，DDR5 为 61.50 美元，DDR4 为 82.796 美元[S04、S07、A04]。

不同公司的收入增速不宜直接排名。财年、会计调整、收入结构和币种都会影响结果。Renesas 的非 GAAP 营业利润与 IFRS 口径差异较大，说明非经常项目可能改变表面利润率。[S17] 经营评估应保留同一口径，并说明一次性项目。

七、中国半导体产业链

中国设备企业季度营收增长 1.31%—17.18%，利润与现金变化需要分别解释。

北方华创、中微和盛美上海季度营收分别为 113.06 亿元、36.35 亿元和 20.24 亿元。[S23—S25] 中微季度归母净利润约 13.09 亿元，扣非净利润约 5.00 亿元。盛美归母与扣非利润的降幅也不同。对设备业务的持续盈利，应采用可比利润、研发投入和经营现金流共同判断。

北方华创前三季毛利率 39.44%，低于上年同期 41.41%。[S23] 公司披露部分物料供应和新产品验证成本的影响。设备收入确认还取决于出货及验收时间。业务增长与交付能力应共同纳入产能安排，避免收入目标超过零件和工程人员供给。

长鑫科技三季度营收 1,187.14 亿元，归母净利润 544.35 亿元。[S26] 上市股东利润与全部净利润分别列示澜起科技披露第四季度互连芯片在手订单约 25 亿—27.9 亿元。[S27] 订单支持后续交付，但仍要核对验收、取消条款和回款时间。

国产计算芯片的采购评估可从业务任务出发。性能、功耗、模型适配、工具链和运维共同决定总成本。客户可按测试、验证和扩容分批采购。设备材料导入也应以工艺窗口、良率与可靠性为依据，避免仅以产地替代质量判断。

八、行业会议与人物观点

本周材料会议与研发合作把注意力转向量测、三维工艺和器件供货。

新加坡 CMC 材料研讨会于 10 月 28 日举行，主题涉及供应、质量与量测。[S36] Lam 与 imec 同日宣布扩大合作，研究三维集成与 High-NA EUV 配套材料。[S21] 联合研发能够支持后续工艺改进。项目目标、客户认证和商业量产仍属不同阶段。

SEMI ITPC 会期为 11 月 1—4 日，采用夏威夷当地时间。[S35] 本期截稿对应夏威夷 11 月 1 日 11:00。首日后续活动仍按日程观察，不把未来发言写成已发生事实。下两周应关注企业对存储供给、设备采购和客户资本投入的新说明。

SK hynix 管理层对 HBM4 产品组合提出第四季度预测。[S01] ASMI 对 2027 年收入给出超过 57 亿欧元的预期。[S06] 这些判断包含企业自身假设。采购与投资决策需要通过后续交付、收入及现金流检验，不把管理层目标直接视为既成结果。

TrendForce 预计高容 MLCC 供应紧张延续到 2027 年上半年。[A06] 该判断涉及具体器件结构与系统配置。供应商应核对客户认可料号和产线能力。替代器件可用性要由测试与认证决定，不能只凭市场报价。

九、趋势判断

8 项判断均设置具体数据前提和反向情形，覆盖 2026 年第四季度至 2027 年。

判断	数据前提	观察期间	反向情形
存储长约执行将影响 2027 年供应安排	SK hynix14 家客户，覆盖超过半数未来两年产能[S01]	2027 年采购计划	客户取消、延期或供应商扩大新增可售产能
设备收入仍有季度增长条件	KLA 下一季中值比本季+13.6% [S05]	下一财季	交付或客户验收晚于计划，服务增长放缓
服务器与 PC 需求继续分开变化	Intel DCAI+78%、CCPG-5%[S04]	未来两个季度	PC 订单恢复，服务器指引明显下调
成熟与特殊工艺存在局部改善	联电利用率 92%、22/28nm 占 35% [S13]	第四季度	利用率跌回 90%以下或出货低于公司预测
消费业务面临物料成本约束	Sandisk 消费收入环比-29%[S12]	第四季度与 2027 年初	终端销量与消费业务收入持续回升
中国设备企业需把增长转为现金	中微季度收入+17.18%；北方华创+1.31%[S23、S24]	未来两个季度	验收和经营现金流连续改善，费用率下降
系统配套器件仍需提前认证	高容 MLCC 紧张预计延续至 2027 年上半年[A06]	2027 年上半年	交期缩短且替代器件大批通过客户认证
长期采购与融资约束将更受关注	630 亿美元 SPV 承诺，交付 2027 年开始[S18]	2027 年交付阶段	资金成本下降、使用率与现金回款持续高于计划

SK hynix 长约覆盖超过一半的 2027—2028 年产能，设备扩张仍取决于合同执行。[S01] 经营团队宜按月比较提货与库存，按季度比较收入与现金流；出现偏差时调整采购批次。

十、主要风险与下周关注事项

库存周转、交付验收和长期采购义务是下一阶段的三类经营约束。

主要风险	事实依据	管理观察
客户现金与长期承诺	630 亿美元 SPV 结构，2027 年开始交付[S18]	检查租赁付款、使用率、客户回款及担保义务
终端需求与物料成本	Sandisk 消费业务环比-29%[S12]	分开制定企业级和消费产品库存计划
库存与周转	MediaTek 库存周转 127 天，前季 102 天[S14]	检查新增备货与经营现金流的关系
设备交付与验收	北方华创季度营收同比+1.31%[S23]	逐项核对关键物料、安装资源及付款节点
价格口径	DDR5 16Gb 现货 61.50 美元[A04]	现货、合约和终端零售分别使用；保留产品与日期

日期	事项	关注内容	修正判断的情形
11 月 3 日（北京）	onsemi 三季度财报	工业与汽车需求、毛利和渠道库存	收入或下一季指引低于公司前期范围
11/2	Tower 季度财报	特殊工艺利用率与扩产安排	交付、客户需求或资本计划改变
11 月 4 日（北京）	AMD 三季度财报	数据中心、加速器交付与 EPYC 需求	下一季度需求或供货计划发生明显调整
11 月 5 日（北京）	Qualcomm 与 Arm 财报交流	手机、授权、计算与 AI 相关业务	收入增长与库存方向发生变化
11/1—4 夏威夷	SEMI ITPC	存储、设备与客户资本支出计划	会议正式披露改变既有供货或投资安排
11/10 13:30 台北	台积电 10 月营收	环比变化与季度指引之间的关系	月度收入明显偏离季度计划对应进度

AMD、Qualcomm 与 Arm 的财报交流分别安排在北京时间 11 月 4 日至 5 日。[S48—S51] 重点观察数据中心需求、手机业务与库存变化。

MediaTek 库存周转增至 127 天。[S14] 对不可取消采购，应按提货日期和库存周期安排付款；新增产能仍需核对客户需求与现金回收。

十一、管理观察与行动建议

六类读者分别根据订单、成本、交付和现金安排下一阶段行动。

芯片设计与系统企业

Intel 服务器业务同比增长 78%，客户计算业务下降 5%。[S04] 按客户用途分配研发预算，结合内存、电源、散热和工具链比较系统成本。

制造存储封测企业

联电利用率 92%，日月光 ATM 毛利率 30.6%。[S13、S58] 将产线负荷、工艺和验收日期共同纳入排产，季度检查长约执行和现金回收。

设备材料企业

KLA 下季收入中值 47 亿美元，较本季增长 13.6%。[S05] 根据客户现场、关键物料与工程人员安排交付，将出货、客户验收和付款分列管理。

中国产业链企业

北方华创季度收入增长 1.31%，中微增长 17.18%。[S23、S24] 分开评价收入、扣非利润与现金流。按客户工艺与可靠性条件确认设备和材料，不仅按产地判断采购价值。

政策研究者

Infineon 至 2034 年计划投入约 11 亿欧元建设 300mm GaN 制造。[S22] 研究应分列投资计划、许可条件与实际产能，并保留不同规则的生效日期和适用交易类型。

上市公司与资本市场研究者

SOX 周跌 0.84%，Intel 周跌 24.38%。[S30 及行情来源] 用同一证券和收盘时点计算收益，区分财报实际、市场预期和公司指引。将会计调整、分红和拆股另行说明。

来源目录

- [S01] SK hynix 三季度业绩｜https://news.skhynix.com/en/q3-2026-business-results/
- [S02] Samsung 三季度业绩｜https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-third-quarter-2026-results
- [S03] Samsung 年度资本支出计划｜https://www.samsung.com/global/ir/reports-disclosures/public-disclosure-view.84797/
- [S04] Intel 三季度业绩｜https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/50863/000005086326000188/q326earningsrelease.htm
- [S05] KLA FY2027 第一季度业绩｜https://ir.kla.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0000319201-26-000032/exhibit991earningsrelease0.htm
- [S06] ASMI 三季度业绩｜https://www.asm.com/downloads/25242322-quarterly-reports/2026-q3-quarterly-report
- [S07] NXP 三季度业绩｜https://investors.nxp.com/news-releases/news-release-details/nxp-semiconductors-reports-third-quarter-2026-results
- [S08] ST 三季度业绩｜https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932787/000093278726000086/c3419c-q326earningspressre.htm
- [S09] TEL FY2027 第二季度业绩｜https://www.tel.com/ir/library/report/i61j9u00000000gf-att/fy27q2presentations-e2.pdf
- [S10] Advantest FY2026 半年度业绩｜https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/E_FR_FY2026_2Q.pdf
- [S11] Kioxia 半年度及季度业绩｜https://ssl4.eir-parts.net/doc/285A/tdnet/2902678/00.pdf
- [S12] Sandisk FY2027 第一季度业绩｜https://investor.sandisk.com/news-releases/news-release-details/sandisk-reports-fiscal-first-quarter-2027-financial-results
- [S13] UMC 三季度业绩及资本预算｜https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1033767/000119312526434992/umc-ex99.htm

- [S14] MediaTek 三季度业绩 | https://www.mediatek.com/hubfs/MediaTek-Assets/Pdfs/Quarterly%20Earnings%20Release/2026/Quarterly%20Earnings%20Release-2026Q3/Press%20Release.pdf
- [S15] Amkor 三季度业绩 | https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-technology-reports-financial-results-third-quarter-2026
- [S16] Cadence 三季度业绩 | https://newsroom.cadence.com/press-releases/press-release-details/2026/Cadence-Reports-Third-Quarter-2026-Financial-Results/default.aspx
- [S17] Renesas 三季度业绩 | https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-reports-financial-results-third-quarter-ended-september-30-2026
- [S18] Broadcom 合作融资结构 | https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/bank-america-blackstone-citi-and-morgan-stanley-announce
- [S19] NVIDIA 与 Oracle 扩大合作 | https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-oracle-expand-nvidia-vera-rubin-to-multi-gigawatt-scale-and-bring-nvidia-vera-cpu-to-oracle-cloud-infrastructure
- [S21] Lam 与 imec 三维集成研发合作 | https://www.imec-int.com/en/press/lam-and-imec-expand-collaboration-advance-manufacturability-next-gen-3d-integration
- [S22] Infineon 300mm GaN 投资 | https://www.infineon.com/press-release/2026/infpr202610-021
- [S23] 北方华创三季度报告 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641389.PDF
- [S24] 中微公司三季度报告公告原文转载 | https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12682260&stockid=688012
- [S25] 盛美上海三季度报告公告原文转载 | https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12671594&stockid=688082
- [S26] 长鑫科技三季度报告公告原文转载 | https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12685093&stockid=688825
- [S27] 澜起科技三季度业绩及订单公告原文转载 | https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12678366&stockid=688008
- [S28] 韩国 10 月进出口月报 | https://www.motir.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/172360/view
- [S29] 中国 10 月制造业 PMI | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfbhjd/202610/t20261031_1965718.html
- [A01] SIA 八月全球半导体销售 | https://www.semiconductors.org/year-to-date-global-semiconductor-sales-top-1-trillion-through-august/
- [A02] SEAJ 九月日本制设备三个月移动平均 | https://www.seaj.or.jp/statistics/87971382478580.pdf

- [A04] TrendForce DRAM 公开价格表｜https://www.trendforce.com/price/dram/dram_spot
- [A06] TrendForce 高容 MLCC 研究｜https://www.trendforce.com/presscenter/news/20261029-13284.html
- [S30] Nasdaq SOX 收盘｜https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/SOX
- [S31] SSE 科创 50 历史行情｜https://yunhq.sse.com.cn:32042/v1/sh1/dayk/000688?begin=-20&end=-1&period=day&select=date,close
- [S32] Treasury 每日收益率｜https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value_month=202610
- [S33] 2026-21786 对外投资规则修订草案｜https://www.federalregister.gov/documents/2026/10/26/2026-21786/outbound-investment-security-program-regulations
- [S34] 2026-21884 氦列入关键材料｜https://www.federalregister.gov/documents/2026/10/27/2026-21884/critical-material-list-addition-of-helium
- [S35] SEMI ITPC 会议议程｜https://www.semi.org/en/event/international-trade-partners-conference-itpc
- [S36] TechInsights 材料会议议程｜https://www.techinsights.com/2026-fall-cmc-seminar
- [S44] 台湾九月外销订单基线｜https://www.moea.gov.tw/MNS/english/news/News.aspx?kind=6&menu_id=176&news_id=124304
- [S48] AMD 财报日期公告｜https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1300/amd-to-report-fiscal-third-quarter-2026-financial-results
- [S49] Qualcomm 财报日期公告｜https://investor.qualcomm.com/news-events/press-releases/news-details/2026/Qualcomm-Schedules-Fourth-Quarter-and-Fiscal-2026-Earnings-Release-and-Conference-Call/default.aspx
- [S50] Arm 财报日程｜https://investors.arm.com/financials/quarterly-annual-results
- [S51] onsemi 财报日程｜https://www.onsemi.com/company/newsroom/news-and-insights/onsemi-to-announce-third-quarter-financial-results

补充公司与行情来源

标的或资料	原文 URL
SCREEN [S56]	https://www.screen.co.jp/download_file/3a09acd3-7e49-4ae3-8c93-19ba261691f0/1169
ASE 财报 [S58]	https://www.prnewswire.com/news-releases/ase-technology-holding-co-ltd-reports-its-unaudited-consolidated-financial-results-for-the-third-quarter-of-2026-302923021.html

标的或资料	原文 URL
华海清科 [S61]	https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-31/1225648256.PDF
SOX 历史 [M09]	https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/%5ESOX?period1=1767139200&period2=1793491200&interval=1d
KOSPI [M01]	https://www.investing.com/indices/kospi-historical-data
SK hynix	https://stockanalysis.com/quote/krx/000660/history/
Samsung	https://stockanalysis.com/quote/krx/005930/history/
KLA	https://stockanalysis.com/stocks/klac/history/
Advantest	https://stockanalysis.com/quote/tyo/6857/history/
TEL	https://stockanalysis.com/quote/tyo/8035/history/
AMAT	https://stockanalysis.com/stocks/amat/history/
NVIDIA	https://stockanalysis.com/stocks/nvda/history/
AMD	https://stockanalysis.com/stocks/amd/history/
Intel	https://stockanalysis.com/stocks/intc/history/
Sandisk	https://stockanalysis.com/stocks/sndk/history/
中芯 A	https://stockanalysis.com/quote/sha/688981/history/
中微公司	https://stockanalysis.com/quote/sha/688012/history/
北方华创	https://stockanalysis.com/quote/she/002371/history/
ETF 512480	https://yunhq.sse.com.cn:32042/v1/sh1/dayk/512480?begin=-20&end=-1&period=day&select=date,close
ETF 159995	https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get?param=sz159995,day,2026-10-23,2026-10-30,10,qfq

百思特变革研究院半导体智库。资料采用截至截稿的公开信息，预测与计划会随经营条件改变。本报告供行业研究参考。